

# 第十一届中国功能材料及其应用学术会议

## 暨 2024 功能材料国际论坛

### 会议通知

(2024 年 05 月 17-20 日, 重庆)

#### 一、会议简介

“中国功能材料及其应用学术会议”(China National Conference on Functional Materials and Applications), 是 1991 年由中国仪器仪表学会仪表材料分会、国家“863”新材料专家委员会、重庆仪表材料研究所等单位共同发起、每三年召开一次的系列会议, 已分别在厦门、北京、武汉、长沙、哈尔滨等地成功举办了十届, 系中国功能材料科技领域中的全国性、综合性的大型学术盛会。旨在促进我国功能材料科技领域中新材料、新技术、新工艺和新产品的研究开发及其推广应用, 促进科研、生产与应用的有机结合, 促进科技成果的产品化、商品化、工程化、产业化与国际化, 以及科技与经济的密切结合, 加快形成新质生产力, 推动我国功能材料的学科繁荣、技术创新与产业发展。

“第十一届中国功能材料及其应用学术会议暨 2024 功能材料国际论坛”拟定于 2024 年 5 月 17-20 日在重庆召开。会议由国机集团新材料产业协同创新联盟、重庆材料研究院有限公司、中国仪器仪表学会仪表功能材料分会等承办。大会设有 20 个学术论坛, 助力国内外功能材料科学技术的深入交流与合作。同期开设 3 个产业论坛, 进行成果展示、需求发布、技术交流等, 推动功能材料产业发展。已有中外院士 19 人, 国家级人才称号百余人确定出席会议并做报告, 更多嘉宾正在邀请中……

## 二、组织机构

### 1. 主办单位

中国仪器仪表学会  
重庆市科学技术协会  
国家仪表功能材料工程技术研究中心

### 2. 承办单位

国机集团新材料产业协同创新联盟  
重庆材料研究院有限公司  
中国仪器仪表学会仪表功能材料分会  
中国仪器仪表行业协会仪表功能材料分会  
重庆功能材料学会  
中国材料研究学会青年工作委员会

### 3. 协办单位

清华大学 北京大学 厦门大学 武汉理工大学 北京科技大学  
复旦大学 天津大学 中南大学 北京工业大学 西北工业大学  
四川大学 重庆大学 西南大学 哈尔滨工业大学

### 4. 大会主席

主 席：潘复生院士 陈学东院士

### 5. 学术委员会

主 席：王中林院士 刘云圻院士

委 员：（以姓氏笔画为序）

王 强 王东哲 王鲁宁 邢 焰 刘永长 刘雪峰 纪荣嵘  
李正操 吴玉程 汪瑞军 宋 成 宋克兴 宋晓艳 张劲松  
张国庆 张善勇 林元华 林学春 周欢萍 郑明光 赵栋梁  
郝晓东 侯仰龙 黄伟九 曾小勤

### 6. 组织委员会

主 席：张清杰院士 顾 宁院士

委 员：（以姓氏笔画为序）

丁书江 于海峰 马东阁 王金斌 云 峰 邓 旭 卢明辉

代 斌 刘 庄 江慧丰 许并社 李 舟 李 焱 李美成  
李 磊 李 璐 杨华明 杨 洪 何 芳 汪 洋 沈国震  
张 斗 张进成 张 勇 张 浩 周小元 周益春 官建国  
赵远锦 胡季帆 侯向辉 姜 勇 姚亚刚 袁 鹏 倪 文  
高 琛 郭胜锋 黄美良 董发勤 董 帆 解孝林 魏大程

### 三、分论坛主题

#### (一) 线上论坛主题

##### 国际先进功能材料线上论坛

论坛主席：潘复生 中国工程院院士

Jürgen Eckert 奥地利科学院院士

John Wang 新加坡国家工程院院士、新加坡国家科学院院士

召集人：袁 媛、谭 军

承办单位：重庆大学

#### (二) 学术论坛主题

##### 分会一、人工智能与高通量计算

分会主席：宋晓艳

承办单位：北京工业大学、北京科技大学

##### 分会二、先进磁性功能材料

分会主席：胡季帆、姜 勇

承办单位：山东大学、天津工业大学

##### 分会三、热功能材料

分会主席：卢明辉、姚亚刚

承办单位：南京大学

##### 分会四、传感材料

分会主席：沈国震、李 舟、魏大程

承办单位：复旦大学、北京理工大学、中国科学院北京纳米能源与系统研究所

##### 分会五、稀土功能涂层材料

分会主席：鲍曼雨、张晓东

承办单位：中国农业机械化科学研究院集团有限公司、中国稀土学会铸造合金专委会、哈尔滨工业大学

#### **分会六、先进金属功能材料**

分会主席：宋克兴、王 强

承办单位：河南省科学院

#### **分会七、功能材料制备加工与检测表征**

分会主席：刘雪峰、黄伟九、高 琛

承办单位：北京科技大学、重庆文理学院

#### **分会八、矿物功能材料**

分会主席：董发勤、倪 文、杨华明、袁 鹏、边 亮

承办单位：西南科技大学、北京科技大学、中国地质大学、广东工业大学

#### **分会九、生物及医用功能材料**

分会主席：官建国、刘 庄、赵远锦

召集人：牟方志、冯良珠

承办单位：武汉理工大学、苏州大学

#### **分会十、能源功能材料**

分会主席：李美成

召集人：李英峰、刘乐浩、王艳红、孙 鑫、姜银珠

承办单位：华北电力大学

#### **分会十一、纳米材料及技术**

分会主席：周小元、董 帆、张育新、黄 进

召集人：甘 霖

承办单位：重庆大学 Nano Materials Science 编辑部

#### **分会十二、先进显示材料及应用**

分会主席：解孝林

召集人：马东阁、于海峰、杨 洪、李 璐

承办单位：华中科技大学、华南理工大学、北京大学、东南大学、重庆文理学院

#### **分会十三、化合物半导体及器件**

分会主席：赵德刚、许并社、张进成、云 峰

召集人：王智勇、马淑芳

承办单位：太原理工大学、西安电子科技大学、西安交通大学、北京工业大学、陕西科技大学、西安市化合物半导体材料与器件重点实验室

#### **分会十四、陶瓷功能材料**

分会主席：周益春、张 斗、石 锋

召集人：王金斌、杨 琼、刘 岗、杨 斌、潘仲彬

承办单位：西安电子科技大学、中南大学、齐鲁工业大学、湘潭大学、西南大学、湖南大学、宁波大学

#### **分会十五、超材料与功能复合材料**

分会主席：李 垚、邓 旭、孙 宽、何 芳

召集人：李晓丹、王庆平、赵弘韬、赵 欣、徐洪波、童仲秋、潘梦瑶

承办单位：哈尔滨工业大学

#### **分会十六、高分子功能材料**

分会主席：丁书江、李 璐

召集人：梁福鑫、周伟东、柏栋予、张道海、翟福强、陈 煜

承办单位：西安交通大学、重庆文理学院、贵州民族大学

#### **分会十七、碳基功能材料**

分会主席：代 斌、史浩飞、侯向辉、李延辉

召集人：魏 忠、于 锋、王 刚

承办单位：石河子大学、新疆兵团绿色化工过程重点实验室

#### **分会十八、高熵合金和非晶材料**

分会主席：张 勇、杨利明、郭胜锋

召集人：姚永刚、马 将、丁 俊、余 鹏、谭 军

承办单位：北京科技大学、西南大学、重庆师范大学、重庆大学

#### **分会十九、先进能源转化/存储材料与器件**

分会主席：吴玉程

召集人：刘家琴、王 岩

承办单位：合肥工业大学

### **(三) 产业论坛主题**

## 分会二十、航天先进材料

分会主席：邢 焰

召集人：李 岩

承办单位：中国航天先进材料联盟、重庆功能材料学会

## 分会二十一、核电先进材料

分会主席：郑明光

召集人：李荣博、黄美良

承办单位：上海核工程研究设计院股份有限公司、核电安全技术与装备全国重点实验室、中广核工程有限公司

## 分会二十二、农机先进材料

分会主席：汪瑞军、宋月鹏

承办单位：中国农业机械化科学研究院新材料技术与装备研究所

## 四、会议征文

### 1. 征文范围

内容包含但不限于各主题范围、未在国内外正式刊物或其他会议上发表的中英文论文。

### 2. 论文要求

(1) 来稿应主题明确，行文流畅，具有创新性、科学性、实用性，数据、结论可信。论文需不涉及国家秘密、商业秘密等保密内容，如出现涉密问题，作者须自行负责。

(2) 来稿请投递 Word 文档（论文模板详见附件：中/英文论文模板），欢迎申请作墙报展示，请备注“申请墙报展示”。

### 3. 论文出版

(1) 部分论文将被收录至会议论文集，会议论文集将不以任何形式公开发表（包括网络发表），仅供会议交流。

(2) 部分中英文论文将被推荐至《IOP Conference Series: Materials Science and Engineering》（SCI 收录）、《Key Engineering Materials》（EI 收录）、《材料导报》（EI 收录）、《表面技术》（EI 收录）、《功能材料》（核心收录），通过期刊正常评审录用后，在正刊发表（期刊正常收取版面费）。

### 4. 投稿方式及时间节点

投稿方式：大会采用网上投稿系统，请登录官网投稿。

征文截稿日期：2024年4月30日

## 五、会议时间、地点及注册费

1、会议时间：2024年5月17-20日

17日：全天报到

18日：开幕式、大会特邀报告、分论坛报告、中国仪器仪表学会仪表功能材料分会第七届理事会换届大会、《功能材料》第八届编委会换届大会

19日：分论坛报告

20日：分论坛报告、会议结束、代表离会

2、会议地点：重庆悦来国际会议中心（重庆市渝北区滨江大道86号）

3、会议注册费：

类别	2024年5月8日前缴费	2024年5月8日后缴费
学生	¥1200	¥1800
非学生	¥2200	¥2800

会议注册费可提前支付也可现场缴纳。

汇款账户信息：

开户名称：中国仪器仪表学会

开户行：工行北京北新桥支行

行号：102100000431

汇款账号：0200004309014464348

付款备注：姓名+单位+功能材料大会

4、注册与缴费方式：

请登录大会官网（<https://ncfma2024.scimeeting.cn>）

或扫描下方二维码注册后进行汇款支付。



大会官方二维码

## 六、联系方式

单 位：重庆材料研究院有限公司（《功能材料》编辑部）

地 址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 8 号

E-mail: gncllq@126.com

联系人电话：

会议咨询：吴国蓁（13650556889）、肖 洁（17723986450）

财务咨询：罗琳青（15123329511）、李 凤（15310690381）

征文咨询：李 峰（18983062661）、陈 东（13983033438）

展览咨询：黄桂春（17783855250）、张 弛（18523160736）

赞助咨询：郑雅文（15923206400）、何伦英（13883104629）

